



三井金属

2021年12月14日

各 位

次世代半導体チップ実装用特殊キャリア「HRDP®」の海外向け量産開始

～ 海外 IC チップ実装デバイスメーカー様向けに 2021 年 11 月より量産出荷開始 ～

当社（社長：納 武士）は、次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP®」※1の事業化について、ジオマテック株式会社（社長：松崎 建太郎）と協働で商品化に向けた量産体制を構築してまいりました。この度、海外の IC チップ実装デバイスメーカー様向けに HRDP®の量産出荷を開始いたしました。

当社が開発した次世代半導体チップ実装用特殊キャリア「HRDP®」は、 $L/S=2/2\mu m$ 以下の超高密度配線デザインを含む次世代半導体チップ実装技術のファンアウト・パッケージを高い生産効率で実現できる特殊ガラスキャリアです。

2021年1月25日付「次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP®」を量産開始」にて、量産採用の第1弾として国内の複合チップモジュールメーカー様向けに量産を開始したことをお伝えいたしました。この度、量産採用の第2弾として、海外の IC チップ実装デバイスメーカー様向けの量産出荷を2021年11月より開始いたしました。このお客様先では、HRDP®を用いて、SiP ※2モジュールを5G市場向けや、その他様々な先端用途向けで製造し、拡販していく計画です。

加えて、現在、国内外で30社以上のお客様がHRDP®を用いたファンアウトプロセスやチップラストプロセスの開発を進めており、2022年度には評価進捗が速いお客様から順次量産採用が始まる予定です。

製造面では、ジオマテック社赤穂工場において、設備の自動化やAIを活用した全工程のスマート化に基づく生産を推進することで、生産効率や品質レベルの向上を図るとともに、将来のHRDP®市場のさらなる拡大に合わせ増産投資も検討していきたいと考えています。

当社は、「マテリアルの知恵を活かす」というスローガンのもと、HRDP®の事業拡大により半導体パッケージ市場への貢献を進めるとともに、事業活動を通じ、サステナブルな社会作りに貢献します。

以上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL : 03-5437-8028 Eメール : PR@mitsui-kinzoku.com

【用語説明】

※1 High Resolution De-bondable Panel の略

※2 System In Package の略

【ご参考】

「ファンアウト・パネルレベルパッケージ用ガラスキャリア付き微細回路形成用材料 HRDP®を開発」

(2018年1月25日付リリース)

https://www.mitsui-kinzoku.com/Portals/0/resource/uploads/topics_180125.pdf?TabModule950=1

「次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP®」を量産開始～複合チップモジュールメーカー様向けに2021年1月より量産出荷開始～」(2021年1月25日付リリース)

<https://www.mitsui->

[kinzoku.com/LinkClick.aspx?fileticket=fcgXzc5Wpjw%3d&tabid=199&mid=826&TabModule950=1](https://www.mitsui-kinzoku.com/LinkClick.aspx?fileticket=fcgXzc5Wpjw%3d&tabid=199&mid=826&TabModule950=1)

HRDP®を利用した、チップラスト工法のイメージ動画

<https://www.youtube.com/watch?v=vHhng-NV9QA>